

ディップ製品の概要

当社では、独自に開発した軟質塩化ビニル樹脂ゾルコンパウンド（鉛フリー）を使用して、ディップ成形により各種キャップ、カバーなどを一貫生産しております。当材料を使用して生産されるディップ製品は、電気絶縁性にすぐれるとともに、多数の製品にて信頼あるUL規格を取得しています。また、当社ディップ製品には鉛及びカドミウムは含有されていません。

ディップ製品の特長

- 電気絶縁性、耐熱老化性にすぐれています。
- 適度な柔軟性があり、電子部品、端子類、電線にフィットします。
- 無圧成形のため、製品の内部歪がなく熱老化時の変形が少ない。
- 成形用金型が安価で製作時間が短い。
- 表面の光沢性にすぐれ、豊富なカラーバリエーションがあります。

各種規格の登録・認定

● 電気用品安全法

登録番号	成形材料	使用温度の上限値
042GAC0435	SS107UFTT	105℃
042GAC0394	SS107UFTC	100℃

● UL規格認定材料

UL File No.	成形材料
E58538	SS107UFTT SS107UFTC

● UL規格認定品

UL File No.	定 格
E55167	105℃—300V, 600V

● CSA規格認定品

CSA File No.	定 格
LR52853・LR52854	90℃—300V, 600V 105℃—300V, 600V

成形材料の性能表

試験項目	単 位	UL規格認定材				試験方法
		標準材 一般用	耐熱老化・難燃用		高絶縁用	
		SS108	SS107 UFTT	SS107 UFTC	エスフレックス E-0	
比 重	—	1.2～1.3	1.2～1.3	1.2～1.3	1.2～1.3	JIS K7112
硬 度 (A型)	—	67±3	77±3	83±3	84±3	JIS K6301
引 張 強 さ	MPa	11.7～15.6	14.7～19.6	13.7～17.6	13.7～17.6	JIS K6723
老化後 (100℃×120HR)	MPa	13.7～19.6	14.7～19.6	13.7～17.6	13.7～17.6	
伸 び	%	300～400	300～400	300～400	300～400	
老化後 (100℃×120HR)	%	300～350	300～400	300～400	300～400	JIS K6911 (大気中)
絶 縁 破 壊 の 強 さ	KV	5～8	7～10	7～10	14～17	
老化後 (100℃×120HR)	KV	5～8	7～10	7～10	14～17	JIS K6723
体 積 抵 抗 率	Ω・cm	10 ⁹ ～10 ¹⁰	10 ¹⁰ ～10 ¹¹	10 ¹⁰ ～10 ¹¹	10 ¹¹ ～10 ¹²	
連 続 使 用 温 度	℃	60	105	100	—	電気用品安全法
熱 変 形 温 度	℃	120	130	135	155	ループテスト
耐 寒 性 (Tf)	℃	—40	—40	—40	—	JIS K6723
燃 焼 性	—	—	UL94V-0	UL94V-0	UL94V-0	UL94
銅 安 定 性	—	優良	優良	優良	優良	UL224
耐 候 性 (透明は除く)	—	優	優	優	優	
耐 オ ゾ ン 性	—	優	優	優	優	
耐薬品性	酸 性	—	優良	優良	優良	JIS K7114
	アルカリ性	—	優良	優良	優良	
注) 非 移 行 性	—	良	良	良	良	

注) 対ステンはテストしてからご使用ください。

●このデータは実測値であり保証値ではありません。

●その他特殊材料として下記の材料もあります。

SS107UF (UL94V-0) 難燃用

●ディップ製品の生産工程及び材料、並びに製品梱包材には米国大気浄化法：第611条に基づくオゾン層破壊物質（クラスI、II物質）は、一切使用しておりません。

